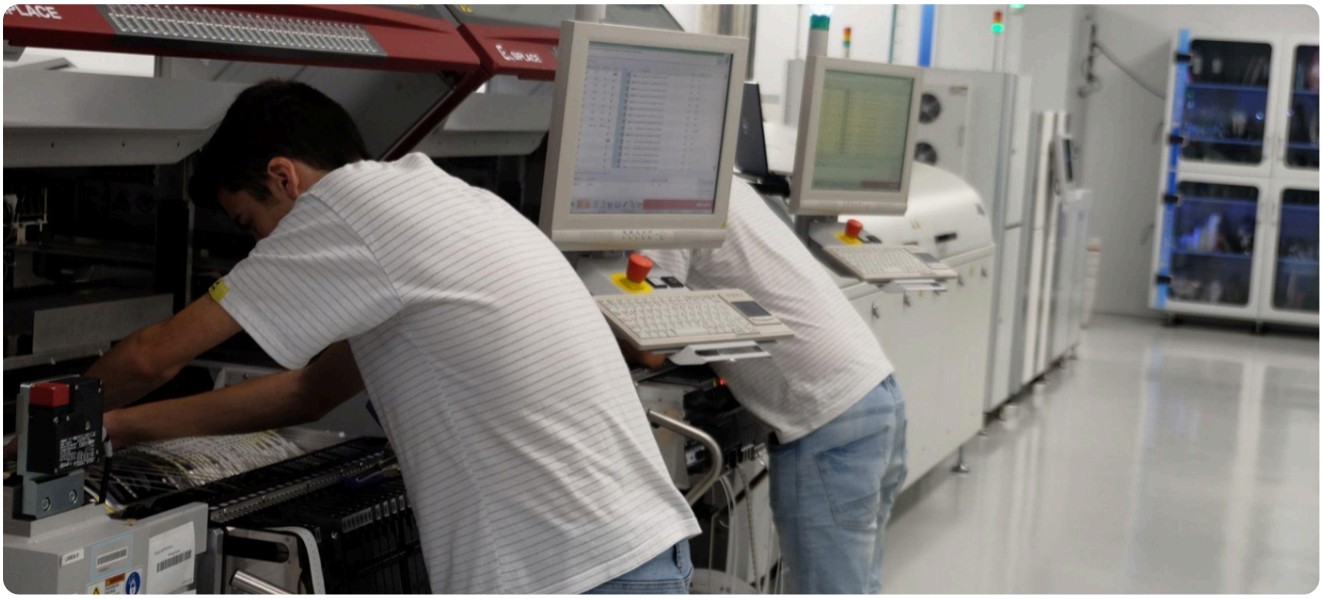
FICHA TÉCNICA · PRODUCCIÓN

Montaje electrónico con inspección y trazabilidad en cada fase.

Partners in technology

Fabricamos PCBA para terceros, de prototipos a grandes series, en una planta propia en Badalona y con ingeniería al lado de cada proyecto.



80.000
colocaciones/h teóricas (20.000–40.000 reales)

400 × 460 mm
panel máximo en la línea SMD (mínimo 80 × 80 mm)

0201 → BGA 0,4
de pasivos 0201 a BGA de 0,4 mm de paso

100 %
de las placas inspeccionadas con AOI 3D

Calidad certificada

ISO 9001:2015 · ISO 13485:2016 · IPC-A-610 · RoHS · Sala ESD · 40 % energía solar propia

Cómo trabajamos

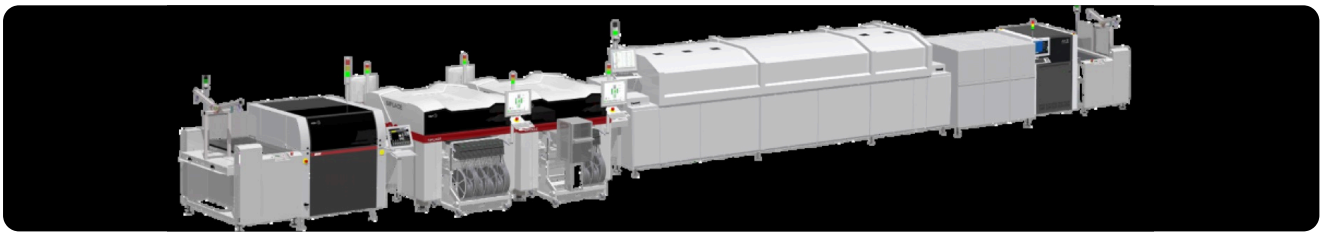
Una sola línea, preparada para prototipos y series. Montamos SMD y THT en una sala antiestática, con procesos estandarizados bajo ISO 9001 e ISO 13485.

Trazabilidad total. Cada placa lleva un código QR: sabemos qué componentes y lotes se han montado, cuándo y qué controles ha superado.

Ingeniería al lado. Revisamos el diseño pensando en cómo se fabricará (DfM) y te proponemos alternativas si un componente escasea.

Línea SMD

Línea ASM completa, de la serigrafía a la inspección final, con carga y descarga automáticas.



Serigrafía	ASM DEK Photon con inspección 2D de pasta (SPI) integrada
Pick & Place	2 × ASM Siplace E: SPEED (cabezal de 12 pipetas) y FLEX (12 pipetas + PP)
Horno de refusión	SEHO Reflow 2.3, 14 zonas (7 + 7), sin plomo; perfilador Mole MAP
Inspección AOI	Omron AOI 3D a la salida, con descarga automática OK / NOK
Manipulación	Multi Magazine Loader, 4 Link Conveyors, Buffer FIFO y Shuttle Unloader

Capacidades

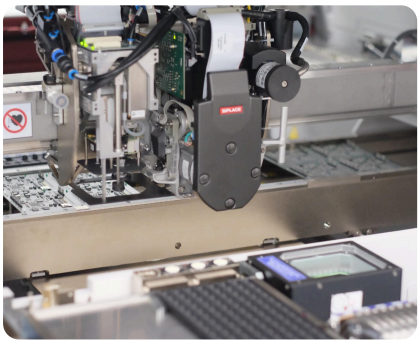
- Componentes de **0201 a 200 × 125 mm**, hasta 50 mm de altura (01005 con actualización)
- **BGA, *µ*BGA, LGA, CSP** de 0,4 / 0,5 / 0,65 / 0,8 mm de paso · **QFN y QFP** de 0,4 mm
- SOT, TSOP, QSOP, VSOP, PLCC, LQFP y LED
- Visión fine-pitch, control de fuerza de colocación y de coplanaridad en tiempo real

Alimentadores y materiales

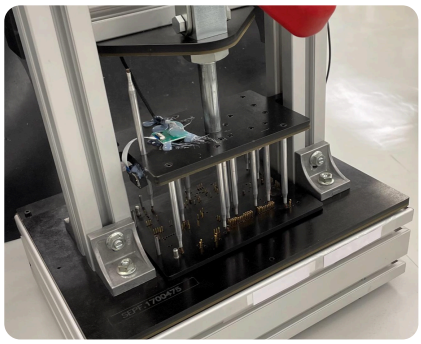
- Bobina: 8, 12, 16, 24, 32 y 44 mm
- Stick: 20 posiciones · Bandeja: 15 bandejas
- Pastas de soldadura Interflux y Kester
- Dos armarios con control de humedad (Essegui) y horno de secado de componentes

THT, inspección y test

Soldadura selectiva	ERSA Smartflow 2020, placas hasta 508 × 508 mm, flux por pulverización y cámara de proceso
Rayos X 2D / 3D	Nordson DAGE Quadra 3 Pro, 70 µm/píxel y cortes X-Plane: BGA, QFN, cortocircuitos, llenado de PTH y detección de falsificaciones (bajo demanda)
AOI 3D	Omron, con estación de programación fuera de línea
ICT y test funcional	Camas de pinchos a medida, fabricadas con fresadora CNC propia y lector QR que guarda los resultados
Flying probe	Servicio subcontratado (SPEA 4050 S2): ICT paramétrica sin utillaje
Rework	Estación de infrarrojos IR6500 para BGA y estación de aire JBC
Protección	Coating (barnizado) y potting (encapsulado)







Montaje final y servicios

- Montaje de conjuntos con **atornillado con control de fuerza**
- **Marcado láser** de PCBA, carcasas y etiquetas
- **Cobot** Universal Robots UR3e de apoyo al operario
- Utillajes impresos en 3D (Ultimaker S5)
- Despanelado semiautomático por disco (V-cut)
- **Compras, almacén y picking** de componentes y producto



Del diseño a la serie, sin cambiar de proveedor

Si aún no tienes el diseño, también lo hacemos: esquemáticos y PCB, firmware, Embedded Linux, FPGA, Edge AI y conectividad. Lo que diseñamos, también lo fabricamos.



Cuéntanos tu proyecto

Envíanos la BOM, los Gerbers y las cantidades, y te preparamos el presupuesto.

info@dracosystems.net
+34 935 607 010
dracosystems.net